

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函

回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕244号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，并根据2026年半年度公司财务数据等相关信息对募集说明书等申请文件进行了更新。具体内容详见公司于2026年9月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》和《关于天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告》等相关文件。

近日，根据项目最新进展，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件以及《问询函》的回复内容进行了相应的修订，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）》和《关于天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日